

Systemes de nettoyage UV JELIGHT



Les systemes de nettoyage UV de JELIGHT sont compacts, conviviaux et performants :

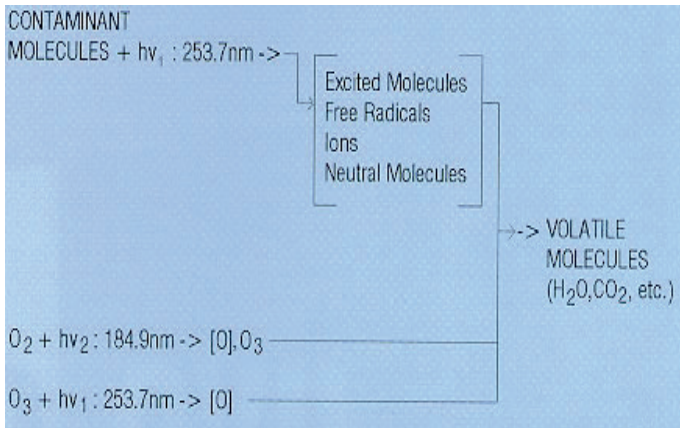
Faciles à utiliser et efficaces, ils peuvent utiliser, en fonction des modes une combinaison entre rayonnement ultraviolet, ozone et chaleur, pour éliminer doucement, mais efficacement, les matières organiques sur une variété de substrats comme le silicium, l'arséniure de gallium (GaAs), le saphir, le métal, la céramique, le quartz et le verre.

Polyvalents, les systemes JELIGHT s'adaptent à une variété d'applications.

Modulaires, ils peuvent être configurés spécifiquement sur commande pour des applications de nettoyage, décapage ou polymérisation.

Tous les systemes sont certifiés CE.

UVO-Cleaner® : une alternative sans dommage

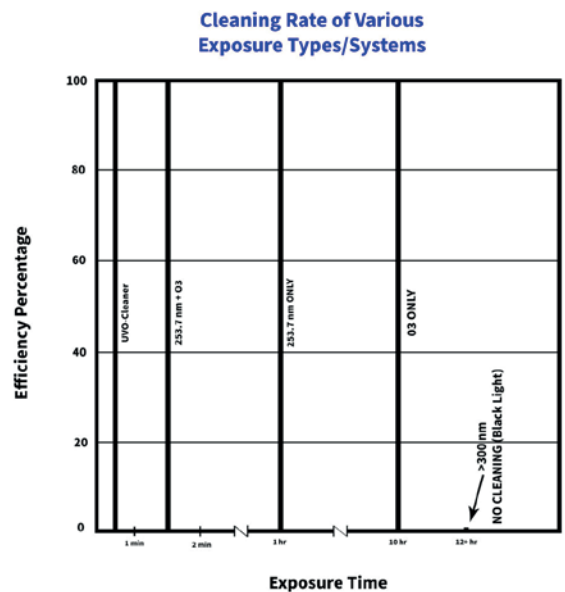


L'UVO-Cleaner® de Jelight est entièrement fabriqué en acier inoxydable poli et est équipé d'une minuterie numérique permettant de contrôler la durée d'exposition aux UV.

De plus, pour un nettoyage efficace et maximal, cet appareil est équipé d'un plateau ajustable pour les pièces à nettoyer, et d'une lampe à grille UV à vapeur de mercure haute pression générant de façon optimale l'oxygène atomique, l'ozone et les rayons UV à ondes courtes.

Enfin, l'UVO-Cleaner® de Jelight est équipé d'orifices d'entrée pour l'oxygène ou d'autres fluides gazeux, et d'un orifice d'échappement pour le raccordement au système d'évacuation.

La méthode UVO est un procédé d'oxydation photosensibilisé dans lequel les molécules contaminantes de résine photosensible, résines, huiles de peau humaines, résidus de solvant de nettoyage, huiles de silicone et flux sont excitées et / ou dissociées par l'absorption de rayons UV à courte longueur d'onde. L'oxygène atomique est généré simultanément lorsque l'oxygène moléculaire est dissocié à 184,9 nm et l'ozone à 253,7 nm. Le rayonnement ultraviolet à 253,7 nm est absorbé par la plupart des hydrocarbures et également par l'ozone. Les produits de cette excitation de molécules contaminantes réagissent avec l'oxygène atomique pour former des molécules volatiles plus simples qui se désorbent de la surface. Par conséquent, lorsque les deux longueurs d'onde UV sont présentes, de l'oxygène atomique est généré en permanence et l'ozone se forme et est détruit en permanence.



En plaçant des échantillons correctement nettoyés à moins de cinq millimètres d'une source UV produisant de l'ozone, telle que la lampe à grille de vapeur de mercure à basse pression de l'UVO-Cleaner®, des surfaces presque propres peuvent être obtenues en moins d'une minute. Le processus n'endommage pas les structures de périphérie sensibles de l'oxyde de grille MOS.

Modèles UVO-Cleaner® Jelight



Modèle	Taille du plateau de nettoyage			Dimension du boîtier			Puissance	
	Largeur (en cm)	Profondeur (en cm)	Hauteur maximale (en cm)	Largeur (en cm)	Profondeur (en cm)	Hauteur (en cm)	Tension	Fréquence
18	7,62	15,24	3,18	29,21	23,50	21,59	120*	60*
24	10,16	15,24	3,18	29,21	23,50	21,59	120*	60*
30	12,7	15,24	3,18	29,21	23,50	21,59	120*	60*
42-220	15,24	15,24	3,81	20,32	33,02	20,32	200-240*	50
342-220	15,24	15,24	8,89	20,32	33,02	25,4	200-240*	50
144AX-220	30,48	30,48	7,62	40,64	60,96	27,94	200-240*	50
256-220	40,64	40,64	7,62	50,8	71,12	27,94	200-240*	50
288A-220	60,96	30,48	7,62	71,12	60,96	27,94	200-240*	50
384-220	60,96	66,04	7,62	71,12	71,12	27,94	200-240*	50
576-220	60,96	60,96	7,62	71,12	91,44	27,94	200-240	50
780	76,2	66,04	31,75	87,63	106,68	31,75	100-240*	*
7576-220	60,96	60,96	17,78	71,12	91,44	38,1	200-240	50
12576	60,96	60,96	30,48	72,39	101,6	54,61	100-240*	*

* Les unités sont disponibles dans les configurations d'alimentation suivantes :

- 120V / 60Hz
- 220V / 50Hz
- 220V / 60Hz
- 100V 50 / 60Hz

** La concentration en ozone et la distance entre l'échantillon et la source UV peuvent grandement affecter le taux de nettoyage.

Fonctionnalités

- Lampe à grille haute intensité
- Boîtier en acier inoxydable
- Equipement abordable
- Minuterie numérique pour des résultats simples et reproductibles
- Plateau en acier inoxydable avec tapis en caoutchouc en option
- Plateau ajustable en hauteur pour les substrats jusqu'à 2,54 cm / 25 mm de hauteur
- Nettoie et améliore automatiquement l'adhérence du revêtement
- Port d'entrée multimédia
- Orifice d'échappement avec destructeur d'ozone et ventilateur en option

Applications

- Suppression de la contamination organique
- Pré-nettoyage de plaquettes (par exemple nettoyage d'un substrat en saphir avant le processus de dépôt de HgCdTe)
- Suppression de résidus sur une résine photosensible ou sur une surface composée de polyimides
- Modification de surfaces afin d'obtenir une meilleure adhérence
- Nettoyage final avant un collage moléculaire
- Séchage UV
- Croissance de films minces d'oxyde stable (GE, Si)
- Nettoyage de pointes AFM

Options

Toutes les unités sont disponibles avec des tueurs d'ozone avec extraction par ventilateur, qui permettent l'utilisation de l'unité sans nécessiter d'extraction externe. Le tueur d'ozone va dissocier les traces d'ozone dans les gaz d'échappement, tandis que le ventilateur augmentera le débit des gaz d'échappement.

Des radiomètres et des détecteurs sont également disponibles pour mesurer les intensités des lampes.



JYFEL CORPORATION SARL

300 RN6, Le Bois des Côtes, Bat. A

69760 Limonest, France

tel: +33 (0)4 26 25 03 30

jyfel.com | info@jyfel.com

